

江苏捷捷微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2018-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	太平洋证券—刘翔、刘尚 超越基金—李静 越创投资—刘刚 深圳行健资本—陈美 琛晟资本—彭安妮
时间	2018年8月15日
地点	江苏省启东科技创业园兴龙路8号2楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事、董事会秘书、财务总监沈欣欣，副总经理张家铨，公司证券与投资者管理专员沈志鹏。
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司基本情况介绍； 2、互动沟通问题（见会议纪要）
附件清单（如有）	
日期	2018年8月15日

江苏捷捷微电子股份有限公司

机构调研会议纪要

会议时间：2018年8月15日星期三 20:00-21:00。

会议地点：江苏省启东科技创业园兴龙路8号2楼会议室

公司出席人员：董事、董秘、财务总监：沈欣欣先生，副总经理、证券投资部部长、证券事务代表：张家铨先生、公司证券与投资者管理专员：沈志鹏先生。

参会机构与嘉宾：太平洋证券—刘翔、刘尚，超越基金—李静，越创投资—刘刚，深圳行健资本—陈美，琛晟资本—彭安妮等。

一、董事会秘书沈欣欣介绍公司概况和2018年半年报情况。

公司创立于1995年3月，1999年筹建3英寸芯片生产线，2008年筹建4英寸芯片生产线，封装生产线完成技改，2013年筹建二极管芯片生产线，并在当年11月形成量产与销售，2014年筹建二极管封测生产线，2015年与中国科学院微电子研究所合作共建“宽禁带电力电子工程技术研究中心”，2017年筹建MOS事业部，2018年募投项目之一半导体防护器件投产。

2018年上半年情况，公司实现营业总收入2.59亿元，较上年同期增长了25.37%，归属于上市公司股东的净利润为8357.03万元，较上年同期增长了14.99%。

公司募投项目建设情况：

1、功率半导体生产线建设项目累积投资金额17,917.76万元，投资进度为95.84%，目前主要工程处在验收期，主要工程量为设备安装调式及验证，预计年内完成试生产，建成投产后第三年达到设计产能。

2、半导体防护器件生产线建设项目累积投资金额13,850.47万元，投资进度为87.80%，尾款主要工程与设备余款和项目流动资金部分。本项目于2017年底完成试生产，2018年已正式投产，预计2020年达到预计效益。

3、工程技术研究中心项目总投资4,500万元，截至报告期末已投资2,876.00万元，完成投资进度为63.93%，该项目尚未完成建设，尚处于建设期。

公司最近几年将继续围绕主营业务，以内生增长为主，外延式发展为辅，通过募投项目建设，存量与增量并存，并结合公司一以贯之的定制化生产和个性化服务等实现国产替代进口，提升市场份额与品牌影响力，深耕于功率半导体领域，做优做强，保持企业健康、稳定、可持续发展。

二、电话交流：

1. 公司产品今年有无涨价的情况，涨价幅度大吗？

答：公司基于原材料等因素影响，自 2018 年 2 月 1 日起对可控硅芯片晶圆和成品的价格作适当上浮，涨价幅度在 3%-5%之间，防护器件基本保持原价。谢谢！

2. 公司募投项目之一的“功率半导体器件生产建设项目”的情况？

答：功率半导体器件生产建设项目总投资 18,696.00 万元。新建电力（功率）半导体器件芯片生产线 1 条，配套器件封装线 1 条。年产出 Φ 4 英寸圆片 42 万片，用于公司生产各类电力电子器件芯片 45,850 万只，自封装电力电子器件 4.28 亿只。截至报告期末，功率半导体生产线建设项目累积投资金额 17,917.76 万元，投资进度为 95.84%，目前主要工程处在验收期，主要工程量为设备安装调式及验证，预计年内完成试生产，建成投产后第三年达到设计产能。本项目目前尚未产生效益，预计 2021 年达到预计效益。谢谢！

3. 公司产品的交货周期情况？

答：公司目前传统标准化产品可在 1 周内交货，新的产品或定制产品，晶闸管系列 7-8 周，防护器件 5-6 周内可以完成交货。常规性定制产品，例如公司主要客户正泰等，公司会根据年度需求量有计划库存备货量，以确保客户的第一时间交期。谢谢！

4. 公司目前的 MOSFET 产品的情况和未来的发展？

答：公司于 2017 年成立的 MOSFET 事业部，研发团队设在无锡市传感器产业园，主要负责芯片设计和产品规划，目前 8 寸芯片流片通过中芯国际，6 寸芯片流片通过四川广义公司等，器件封测在启东（捷捷微电），今年上半年实现少量销售，毛利率接近 20%。

量产与业绩预期还需要较长的周期，力争在 2020 年实现部分量产。公司在启东经济开发区新拿的土地是作为“电力电子器件生产线项目”的实施地点，此项目主要为 MOS 和 IGBT 产品，该项目近期刚通过环评，取得土地证，总平图规划等，预计基础设施于今年 9 月份开工建设，明年 9 月底完成基础设施建设。公司充分考虑到 IDM 是功率半导体器件核心竞争力要素之一，同时结合该项目的芯片产线（8 寸线）投资大、周期长等关键因素，近期芯片还是以流片为主，公司会适时作出规划与安排，敬请投资者关注公司相关的公告。谢谢！

5.为什么公司的毛利率水平这么高？

答：公司通过多年技术积累、产品升级、定制化生产，个性化服务和替代进口等，公司产能、品质等均得到了提升，公司毛利率保持稳定且相对较好的水准，主要原因是公司作为规模偏小的民企，选择了一款适合公司可持续发展的晶闸管功率半导体系列产品，并一直专注于功率半导体主业发展，前期侧重芯片设计与制造，较好地掌控其核心部分，并通过 IDM 一体化的运营模式，具备替代进口可持续能力，同时，公司产品在应用领域、定价和成本控制等优势，相比国外同类产品具备一定的性价比，目前公司系列产品价格为国外同类产品的 70%左右。基于公司晶闸管系列产品应用领域等，未来几年的赢利能力具备可持续性。谢谢！

6.公司各类下游客户的占比情况？

答：公司产品主要应用于：家用电器、漏电断路等民用领域；无功补偿装置、电力模块等工业领域；通讯网络、IT 产品、汽车电子等防雷击和防静电保护领域。按照产品的应用领域的不同，大致分为这几个类别：白色家电、小家电、漏保、电力电子模块、照明、安防、通讯、电表、汽车电子、电动工具和摩配等。白色家电占比大约 12%，电动工具占比大约 10%，汽车电子占比大约 3%，安防占比大约 10%，电表占比大约 5%，小家电占比大约 17%，低压电器占比大约 20%，照明占比大约 6%，通讯占比大约 6%，电力模块占比大约 5%等。谢谢！

7.公司今年芯片产能的情况？

答：今年的芯片产能利用预计可以达到 160 万片（4 寸片），半导体芯片的产能结合产品结构、作业时间、工艺改进等具有一定的弹性。谢谢！

8.公司产品芯片的自用和外销比例？

答：公司是集芯片生产，器件生产，封测一体的全产业链企业。生产的芯片用于晶闸管系列的产品芯片，约 70%用于自封，约 30%卖给封装企业；防护器件（二极管）系列的产品芯片，约 40%用于自封，约 60%卖给封装企业，总体上芯片的自用封测率接近 60%，今后几年会有年提升。谢谢！

9.公司主要产品晶闸管和防护器件的技术难度和行业门槛？

答：从芯片生产工艺与工步等角度来看，晶闸管芯片生产周期平均为 35 天，要经历 6-8 次光刻，相比 6 寸线的 MOS 芯片的生产周期要长一点，相比其他分立器件生产周期长、工步多、工艺较复杂等，具备一定的技术难度和行业门槛。公司目前防护器件芯片的生产周期平均为 25 天，要经历 4-5 次光刻，相对工艺比较复杂，生产周期长，公司部分芯片具备一定的先进性。器件的封测对装备的依赖性相对要高，公司这几年在这方面作了一定的投入（包括募投项目建设内容）。谢谢！

江苏捷捷微电子股份有限公司

2018 年 8 月 15 日